



平成 18 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営企画室長
西村 永和
TEL (075) 692 - 0251

ボンダー関連装置の技術移転に関するお知らせ

当社はこの度、ボンダー関連装置（スタックダイボンダおよびテープ貼り付け装置）ならびにその周辺装置を澁谷工業（本社：石川県金沢市 社長：澁谷弘利氏）へ技術移転することといたしましたので、お知らせいたします。

当社は 2006 年 3 月 31 日に発表しました中期経営計画「Challenge30」に基づき、世界トップシェアをもつモールドィング分野とそれに連なるシンギュレーション分野に経営資源を集中することとし、同技術の技術移転について澁谷工業と交渉を進めてまいりました。

なお、ボンダー関連装置の 2006 年 3 月期の売上高は 2 億 65 百万円と小規模（全売上高に対する構成比 1.3%）であり、この技術移転に伴う当社の損益に与える影響は軽微なものであります。

以 上